

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SOLOMON
SYSTECH**

SOLOMON SYSTECH (INTERNATIONAL) LIMITED

晶門半導體有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2878)

盈利警告

本公告乃由晶門半導體有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱作「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09(2)(a)條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

本公司董事會（「董事會」）謹此知會本公司股東及潛在投資者，根據本集團截至2026年6月30日止六個月之未經審核綜合管理賬目初步審閱以及董事會目前可得資料，本集團預期截至2026年6月30日止六個月將錄得股東應佔未經審核綜合虧損約3.8百萬美元至4.1百萬美元，而截至2025年6月30日止六個月則錄得股東應佔未經審核綜合溢利約4.0百萬美元。2026年上半年錄得股東應佔未經審核綜合虧損之主要原因為(i)銷售額、毛利及毛利率減少。減少主要由於生產成本因全球晶片生態系統中的半導體產業鏈出現瓶頸而增加，產出即使在需求增長的情況下受限；(ii)新產品的研發開支增加；及(iii)人民幣升值導致中國大陸的營運成本增加。

儘管2026年上半年之股東應佔未經審核綜合溢利較2025年上半年有所下降，惟董事會謹此強調，本集團於2026年上半年仍能維持穩定的IC付運量，顯示本集團即使於不利的市場狀況下，仍有能力維持穩定的市場份額。與此同時，我們會繼續投入資源支持本集團不同研發項目以維持本集團的長遠競爭力，並將繼續實施現行有效且嚴格的成本控制措施以提高營運效率。

本公司仍在擬定本集團截至2026年6月30日止六個月之中期業績。本公告所載列之資料僅為基於董事會對本集團截至2026年6月30日止六個月之最新及尚未經本公司獨立外聘核數師審閱或審核，亦未經董事會審核委員會審閱之未經審核綜合管理賬目所作之初步評估。本集團截至2026年6月30日止六個月之未經審核綜合中期業績可能需作進一步調整，並可能與本公告所載資料有所不同。本集團財務資料之進一步詳情預期將於2026年8月底前公佈之本公司截至2026年6月30日止六個月之中期業績公告中公佈。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
晶門半導體有限公司
行政總裁
王華志

香港，2026年7月17日

於本公告刊發日期，董事會由(a)執行董事－王華志先生(行政總裁)；(b)非執行董事－楊琨先生(主席)、劉斐女士及謝鈺鈺先生；及(c)獨立非執行董事－陳正豪博士、郭海成博士及陳志光先生組成。